

单组分导热凝胶 RH-TCG-1431 说明书

特色:

- 单组分 (热) 固化导热硅凝胶
- 高热稳定性, 耐热冲击循环
- 低挥发分、低应力、低粘度、低 BLT, 抗 pump out
- 金刚石填料体系

产品组成

- 硅凝胶
- 导热填料

产品应用

- 电子产品及高频设备的界面散热材料

常见性能参数

产品名称	RH-TCG-1431
颜色	黄
固化温度/时间	150℃ 加热 1h
室温操作时间	>3 h
使用温度	-40-200 °C
导热率	> 11 W/m·K
粘度	300000 mPa·s
密度	3.4 ± 0.1 g/cm ³
阻燃等级	UL94 V-0
体积电阻率	>10*10 ¹²
介电强度	>4 kV/mm

应用方法

建议使用点胶机进行点胶操作。

运输储存条件

双组分包装:

- 低于 2-8℃ 运输
- 冷冻保存
- 最佳使用期限为 6 个月以内

其他注意事项

- 工艺过程避免接触 N, S, P 等杂质
- 配方配置时, 需注意避免高温 (80 摄氏度以上)
- 如需返工, 再次使用前需清洁表面
- 注入胶过程中应避免气泡
- 避免人体皮肤直接接触